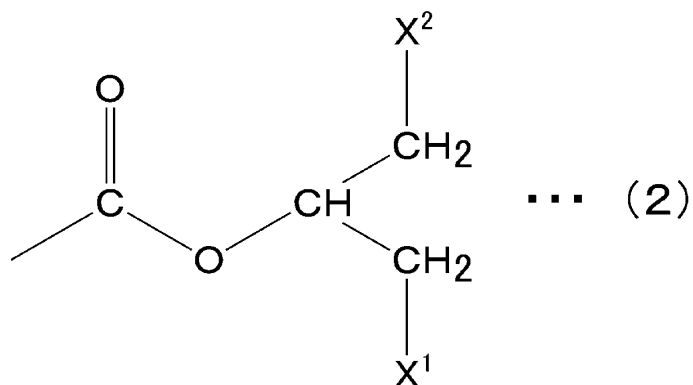
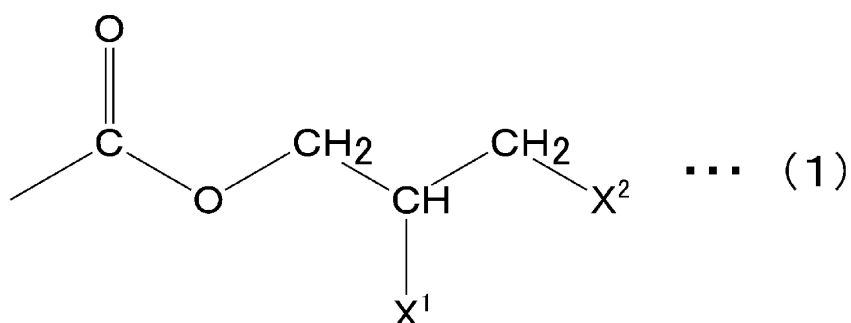


請求の範囲

[請求項1] (A) 導電性粉末および(B)樹脂成分を含有し、前記(A)導電性粉末として、少なくとも銀を用いた銀系粉末が用いられ、前記(B)樹脂成分として、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂の少なくとも一方が用いられ、さらに、下記一般式(1)または(2)で示されるエステル構造を分子中に有し、分子量が150～2000の範囲内である(C)エステル系化合物

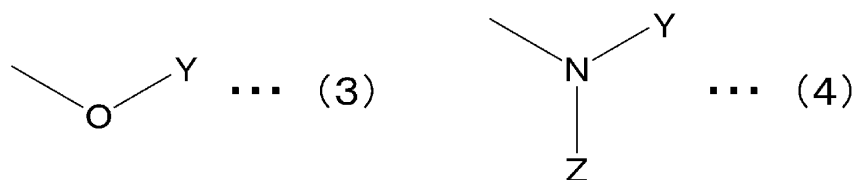
[化1]



(ただし、上記一般式(1)または(2)のエステル構造におけるX¹およびX²は、いずれか一方がC lまたはB rであり、他方がC l、B r、HまたはO Hである。)、または、下記一般式(3)で示されるエーテル構造、もしくは、下記一般式(4)で示されるアミン構造を分子中に有し、分子量が150～30000の範囲内である(D

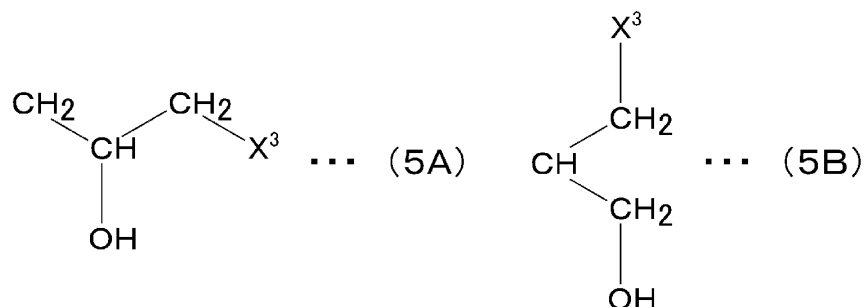
) エーテル／アミン系化合物

[化2]



(ただし、上記一般式(3)のエーテル構造または上記一般式(4)のアミン構造におけるYは、下記一般式(5A)または(5B)に示すアルコール構造のいずれかであり、

[化3]



上記一般式(4)のアミン構造におけるZは、上記一般式(5A)または(5B)に示すアルコール構造のいずれか、もしくは水素原子(H)であり、上記一般式(5A)または(5B)におけるX³はそれぞれ独立してClまたはBrである。)を含有していることを特徴とする導電性ペースト組成物。

[請求項2]

前記(A)導電性粉末および(B)樹脂成分の合計量を100質量部としたときに、前記(C)エステル系化合物もしくはその塩、または、前記(D)エーテル／アミン系化合物の含有量が0.01質量部以上5質量部以下であることを特徴とする、請求項1に記載の導電性ペースト組成物。

[請求項3]

前記(C)エステル系化合物もしくはその塩、または、前記(D)エーテル／アミン系化合物の含有量が0.1質量部以上2.5質量部

以下であることを特徴とする、請求項 2 に記載の導電性ペースト組成物。

[請求項 4] 前記銀系粉末が、銀粉末および銀コート粉末の少なくとも一方であることを特徴とする、請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の導電性ペースト組成物。

[請求項 5] 前記 (C) エステル系化合物には、当該 (C) エステル系化合物の前記エステル構造の一部が、エステルではなく塩基によりカルボン酸が中和された塩構造を有するものが含まれることを特徴とする、請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載の導電性ペースト組成物。

[請求項 6] 前記 (B) 樹脂成分が、ブチラール樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂から選択される少なくともいずれか 1 種であることを特徴とする、請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載の導電性ペースト組成物。